



Vacuum Technology and Innovative Ideas

第**100**期 事業報告書

2003.7.1 → 2004.6.30

株式会社アルバック

ULVAC



代表取締役社長 中村久三

アルバックは2004年4月20日をもって東京証券取引所市場第一部に株式を上場いたしました。永年にわたりアルバックをご支援くださったお客様、お取引先の企業様、ならびに新たにアルバックの株主となられました皆様へ厚く御礼を申し上げます。

1952年の創業以来、アルバックは、独創的な商品開発への飽くなき挑戦と、生産技術のたゆまぬ革新を続けてまいりました。こうした独創性の追求は、いままアルバックのDNAとして社員一人ひとりの中に脈々と息づいています。

いま上場企業として新たな第一歩を踏み出したアルバックは、総合的なソリューションによって顧客満足の最大化を図る一方、真空技術の総合利用による産業と科学への貢献を通じて企業価値の一層の向上をめざしてまいります。株主、投資家の皆様にはさらなるご支援とご鞭撻をお願い申し上げます。

東証一部に株式を上場いたしました。 今後何年間かにわたって、最高の業績を上げられる チャンスの時を迎えたと考えています。

Q 2003年度は、アルバックにとってどのような年度だったのでしょうか。

A 2003年度は売上高で過去最高を達成しましたし、経常利益も目標値をクリアできました。こうした点で非常に実りの多い年だったと思っています。われわれは今後何年間かにわたって、最高の業績を上げられるチャンスの時を迎えたと考えていますが、その初年度として良いスタートを切ることができました。

事業分野別に見ると、今回一番良かったのは液晶ディスプレイ(LCD)とプラズマディスプレイ(PDP)の製造装置です。当年度は40インチを超える大型テレビ用ディスプレイの市場が拡大し、それに伴ってアルバックにも巨額の開発投資や設備投資が求められましたが、シェアを落とすことなく十分な投資をおこなったことが、好業績の大きな要因だと考えています。

Q 2003年度に最も力を入れた経営テーマは何でしょうか。

A いま最も力を入れているのは「生産技術の革新」です。2001年から生産改革を進めてきましたが、2003年7月には、副社長を責任者とする生産本部という新組織をつくり、生産改革は第2フェーズに入りました。2003年度はその初年度として、コストダウンと信頼性の確保に全力で取り組みました。

なぜ生産技術かと言うと、製造業で一番大事なのは良いものを安くつくることだからです。商品開発力やマーケティング力は、他社よりも少し先を行くという点では非常に重要な要素で継続的に注力していきますが、世界のラストワン企業になれるかどうかは、コスト競争力にかかっています。しかもアルバックの製品は他に類のない最先端のものですから、その生産技術に教科書はありません。従って、自分たちで工夫してやっていかなければならないので、そこに経営資源を投入しているわけです。

Q グローバル展開の中で とくに重要視している地域はどこでしょうか。

A アルバックの主力商品である製造装置は、お客様が成長しよ
うとするとときに売れていきます。フル生産しているが、もう設備
投資はしないという飽和状態では、売上は期待できません。だ
から、いま良いか悪いかということではなく、成長しているかどうか
重要になってきます。日本は成長が止まっているわけではありませんが、
だんだん飽和状態になっています。やはり今後も高い成長が期待される
ところ、つまり韓国、台湾、次は中国です。

5年くらい先には中国が世界の製造業と経済の中心になると言われて
おり、われわれはそこでシェアを取り、名実ともに世界のトップ企業に
なるうとしています。そのための布石として、現在、中国において拠点
の新設や拡充を積極的におこなっています。

Q アルバックは世界最大のFPD製造装置メーカー ですが、この分野における優位性は何でしょうか。

A われわれの強みはますあらゆるディスプレイを手掛けている
ことです。LCDのスバツタ装置では世界で圧倒的なシェアを
持っていますが、一方で有機ELとかPDPといったこれからの
製造装置もやっています。LCDで培ったノウハウが他の装置でも活かせる
し、シナジー効果が期待できます。また、様々なディスプレイをサ
ポートしてくれるということで、お客様からの信頼も厚くなっていきます。

もうひとつの強みは、FPDでの経験が、他のテクノロジーを開拓する
源泉になっているということです。アルバックはいま、ファインケミカル、
ファインメカトロニクス、バイオという3つのキーテクノロジーに取り
組んでいます。その典型的なものがインクジェット装置ですが、これは
高分子の有機ELをやっていたから可能になったことです。FPDの技術
蓄積が事業フィールドの拡大につながっています。

Q 今後、とくに有望だと考えている 新規事業分野は何でしょうか。

A アルバックには本格的に事業化できそうなシーズが数多くあり
ます。そのひとつは、ハイブリッドモジュール用の製造装置です。
CCDカメラなどのデジタル家電には高密度に実装したハイブ
リッドモジュールという部品が使われています。エッチング装置ひとつ
とっても、材料はガラス、石英からポリイミド、有機物まで非常に多彩で、



そのすべてに対応できるアルバックは、この分野でトップ企業になれる
と思います。

ハイブリッドカーも有望です。ハイブリッドカーのモーターに使われる
希土類永久磁石やニッケル水素電池は、真空技術を使った溶解炉とか焼結
炉でつくられます。またそれを動かすときに必要なパワーICは50から
100ミクロンの極薄ウェーハなので、その製造装置には特別な技術やノウ
ハウが必要になりますが、ここでもアルバックの技術が活かせると思います。

Q 2004年度(2005年6月期)の事業環境と 業績の見通しを教えてください。

A FPDの需要は、いずれピークを迎えるだろうと思います。
したがって、それまでは、アルバックはFPD製造装置を牽引力
として成長できると考えています。2004年度の連結業績
予想については、売上高1,920億円、営業利益118億円、経常利益110
億円、当期純利益59億円を計画しています。これをステップに2005年
度はさらに成長したいと考えています。

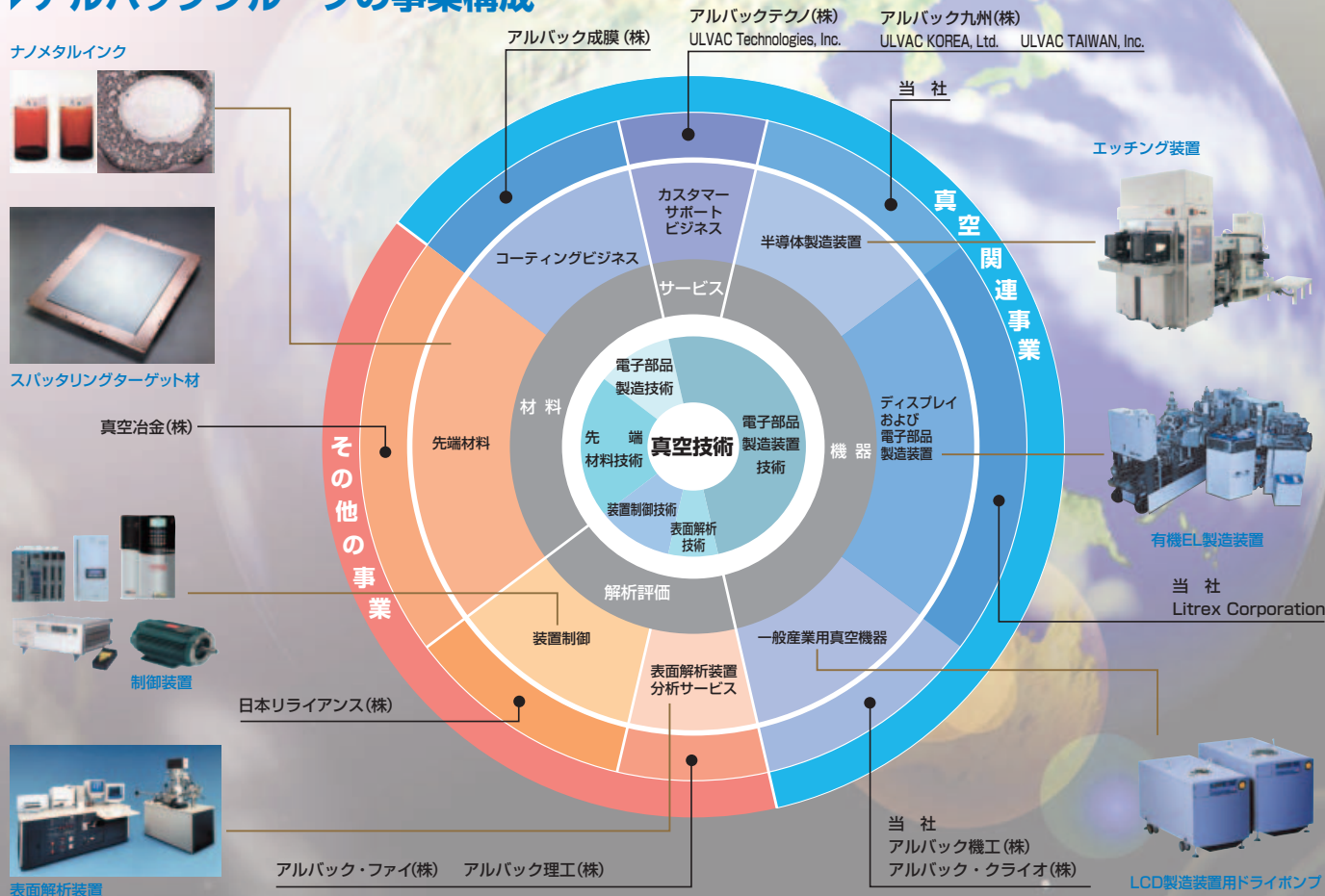
しかし、この間にFPDだけをやっているわけにはいきません。FPDの
動向はアルバックにとって大きなリスク要因ですから、ピークを迎えた
後も継続して成長を続けるためには、ポストFPDの製品を準備すること
が必要です。ポストFPDの商品開発を進め、なおかつ最高の収益を上げ
ていくという二つの目標を同時に達成いたします。

代表取締役社長 中村久三

◆お客様のご要望に応じた提案や機器でアルバックソリューションズを提供しています。

アルバックは、世界有数の真空総合メーカーとして、装置・機器だけでなく、関連材料、解析評価、カスタマーサービスまでを統合したアルバックソリューションズを展開し、グループならではのシナジー効果を発揮しています。継続的なサポートによってお客様のさまざまな要望に応え、付加価値の高い製品やサービスをお届けして、アルバックブランドのいっそうの信頼の向上を図っています。

▶アルバックグループの事業構成

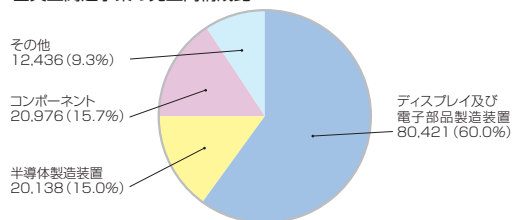


◆ディスプレイや半導体製造装置が主力製品です。

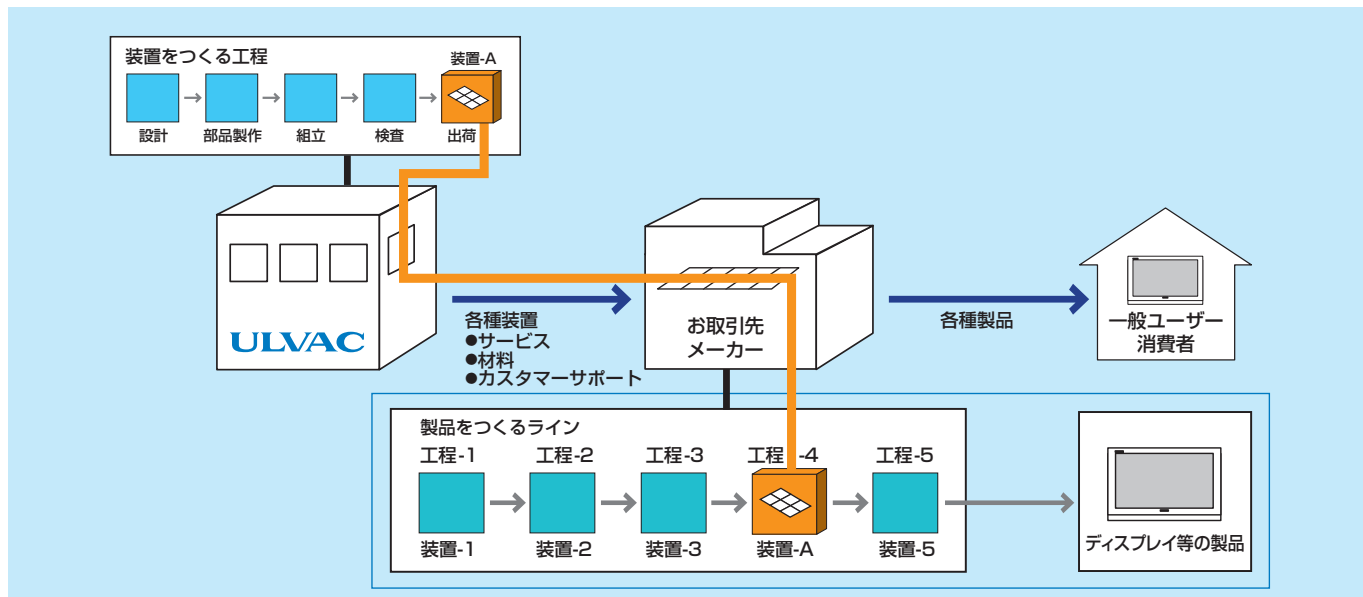
装置中心から材料や周辺サービス領域へ。エレクトロニクスからバイオやエネルギー・環境分野へ。アルバックの事業フィールドは拡大と多様化を続けています。しかし、その土台となるのはやはり世界のトップシェアを有するフラットパネルディスプレイ (FPD) などの製造装置。液晶 (LCD) だけでなくプラズマ (PDP) や有機EL でも確かな地歩を築いています。これら各種ディスプレイの製造装置と電子部品や半導体の製造装置を合わせると、アルバックの真空関連事業全体の約75%に達します。

■真空関連事業の売上高構成比

単位：百万円



◆お取引先を通じて、様々な製品づくりに役立っています。



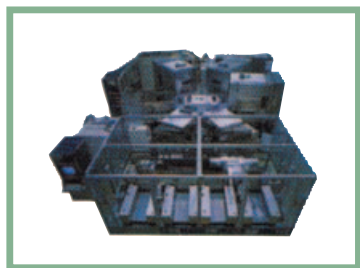
装置メーカーであるアルバックの製品を一般消費者の方々が見る機会はほとんどないでしょう。しかし、お取引先メーカーを通じて、アルバックの技術や装置を使ってつくられる様々な製品は、人々の暮らしと密接なつながりを持っています。例えばコンピュータの

液晶画面や、大画面の薄型テレビの多くはアルバックのFPD製造装置でつくられています。また半導体製造装置や電子部品製造装置は、国内外の電機メーカー等に納入され、携帯電話、デジタル家電、光通信デバイスなどの生産になくてはならないものとなっています。

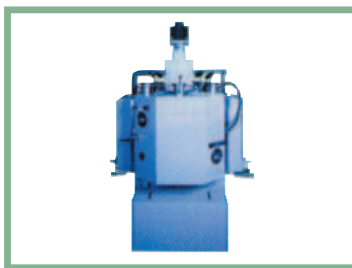
Vol.1 アルバックのスパッタリング装置

アルバックの多彩な装置群の中でも、世界トップのシェアを有するのが、液晶ディスプレイ(LCD)や半導体を製造する際に使われるスパッタリング装置です。特にLCDは近年急速にマザーガラスの大型化が進み、それに伴ってスパッタリング装置も進化を加速させています。スパッタリング装置はまた、デジタルカメラや携帯電話の光学膜コーティングなど、さまざまな分野で使用されています。装置だけでなくそこで作製される製品の製造ノウハウ(成膜プロセス)も提供できることが、アルバックの大きな強みとなっています。

●液晶ディスプレイ製造用
スパッタリング装置(SMDシリーズ)



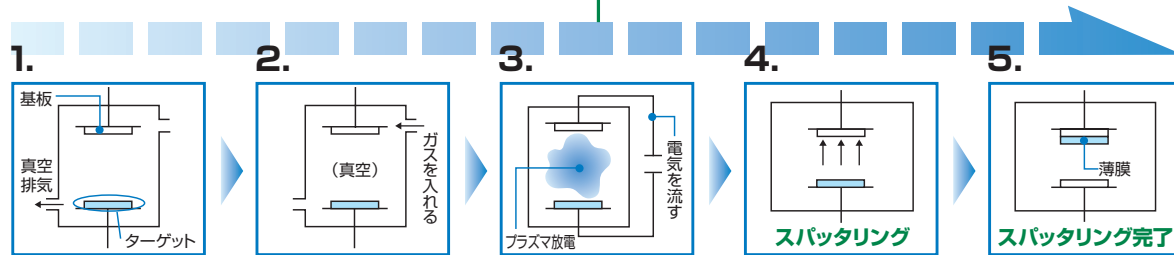
●光学膜用
スパッタリング装置(ULDis)



●半導体製造用
スパッタリング装置(Entron®)



スパッタリングワークフロー



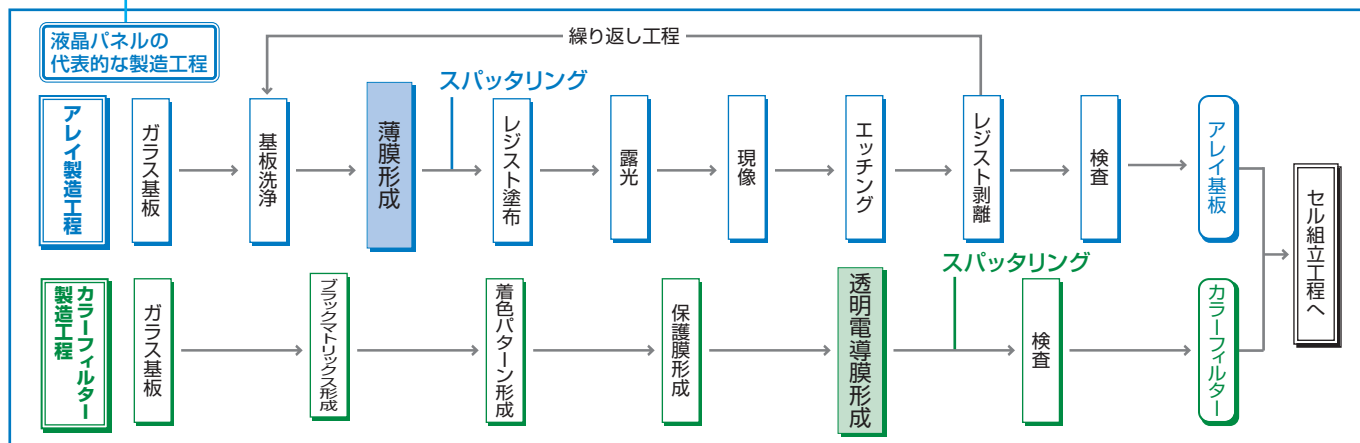
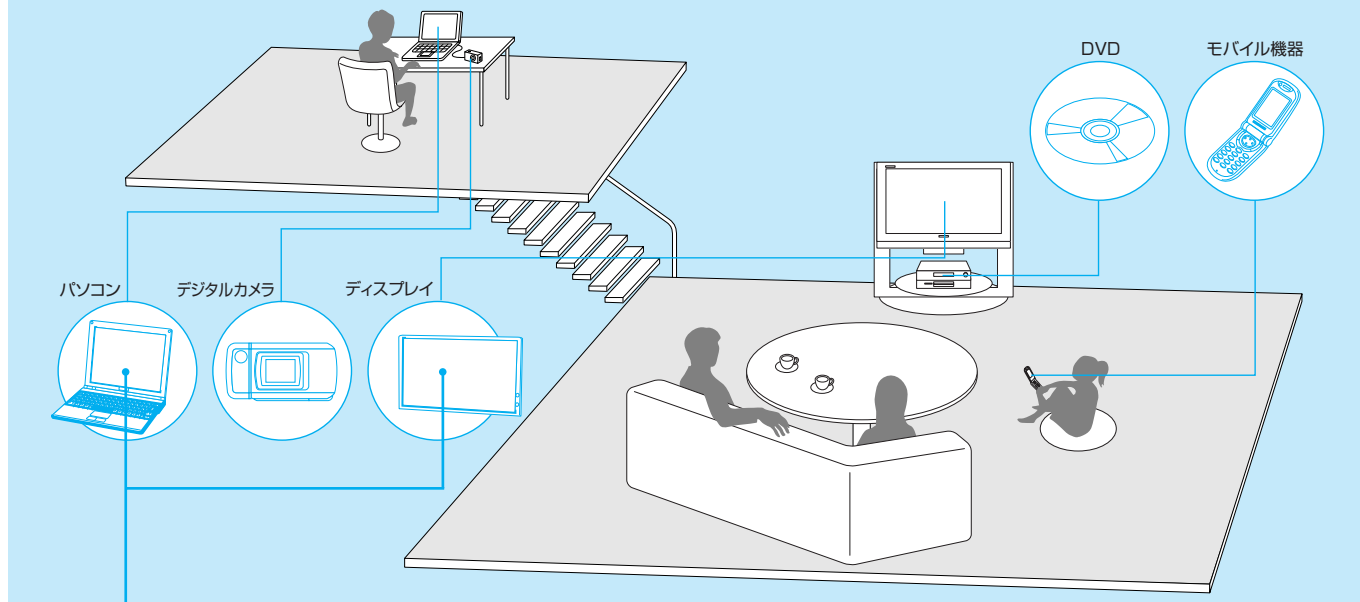
Q
スパッタリングとは？

A
モノをコーティングすることです。

スパッタ(Sputter)とは「飛び散る」という意味です。ターゲットと呼ばれる素材をプラズマを使って「飛び散らせ」、対象物に付着(蒸着)させてコーティングすることから「スパッタリング」といわれています。業界では、一般的に薄膜を形成するための「薄膜技術」を指し、この技術は広範囲に使用されています。スパッタリングを真空中で行うのは、空気に含まれている不純物の付着を防止し、高純度な薄膜を形成するためです。

◆暮らしの中のアルバック

◎私たちの身近にある様々なデジタル家電には、アルバックのスパッタリング装置が重要な役割を果たしています。



▶ 営業の経過及び成果

当連結会計年度（2003年7月1日から2004年6月30日まで）

当連結会計年度の世界経済は、イラク情勢などの不安定要素がありましたが、米国では雇用環境の好転などにより好調な景気が持続しました。また、韓国、台湾や中国などのアジア地域でも設備投資が堅調に推移し回復基調が鮮明となりました。一方、わが国経済は、製造業全般で設備投資や輸出の増加にささえられ、堅調に推移いたしました。

このような状況において、当社グループの主要なお客様であるディスプレイや半導体関連の業界では、薄型テレビ（液晶テレビ、プラズマディスプレイ）やデジタルカメラ、DVD（デジタル多用途ディスク）、携帯電話などのデジタル家電市場が拡大し、韓国、台湾を中心に積極的な投資がおこなわれました。

当社グループはこのような経営環境に対処するため、独創的な新製品をタイミング良く市場投入しアルバックソリューションズの推進による積極的な受注活動をおこなってまいりました。また、お客様からの価格引き下げ要求による販売価格の下落に対し、生産改革第2段階の推進によりコストダウンを図るとともに、諸経費の削減を継続することで、固定費の圧縮を進めてまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績は受注高1,781億96百万円と前連結会計年度に比べ304億29百万円（20.6%）増加し、売上高につきましては、1,578億51百万円と前連結会計年度に比べ303億78百万円（23.8%）増加いたしました。当連結会計年度の損益につきましては、経常利益72億66百万円となりました。なお、当期純利益につきましては、39億53百万円となりました。

▶ 真空関連事業

ディスプレイ及び電子部品製造装置、半導体製造装置、コンポーネント、その他真空機器

ディスプレイ及び電子部品製造装置につきましては、韓国、台湾や日本において第5世代、第6世代液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなどの設備投資が積極的におこなわれ、枚葉式スパッタリング装置「SMDシリーズ」、インライン式スパッタリング装置「SDPシリーズ」、イン

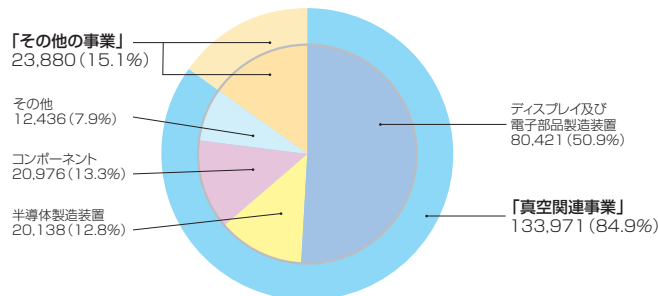
ライン式真空蒸着装置「ECHシリーズ」の売上が好調を維持しました。

また、半導体製造装置はデジタル家電関連だけでなく、自動車関連向けパワーICやLEDなどの化合物半導体における設備投資がおこなわれ、スパッタリング装置「CERAUSシリーズ」、「ENTRONシリーズ」やエッチング装置「NEシリーズ」、「NLDシリーズ」などの売上が好調でした。

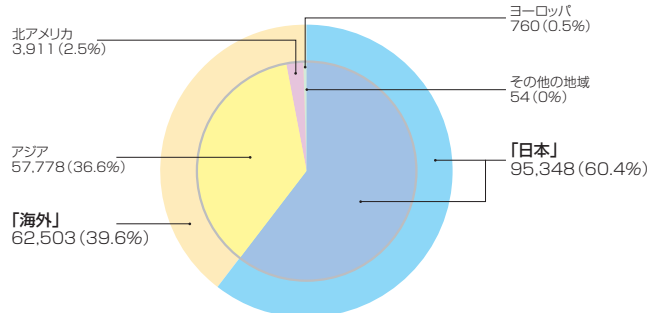
コンポーネントは、主に液晶ディスプレイ製造装置向けの大型ドライポンプやクライオポンプ、自動車部品業界家電業界向け真空ポンプなどの受注、売上が好調でした。

その結果、受注高につきましては、1,541億63百万円、受注残高756億8百万円、売上高につきましては、1,339億71百万円となりました。また、営業利益につきましては、77億38百万円となりました。

● 事業別売上高(単位:百万円)



● 地域別売上高(単位:百万円)



▶その他の事業

先端材料、表面解析装置、装置制御等

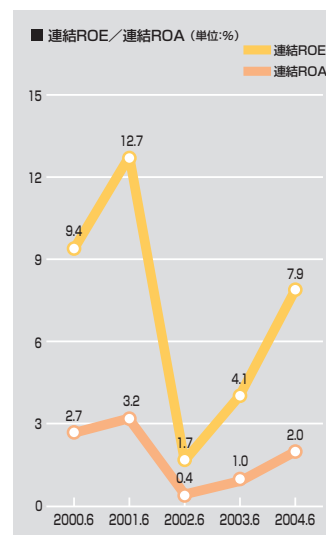
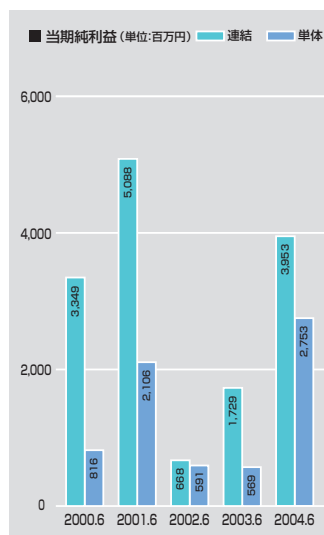
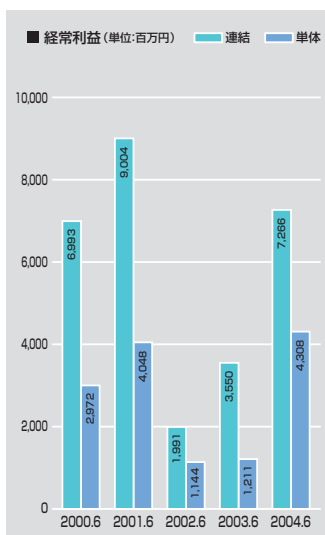
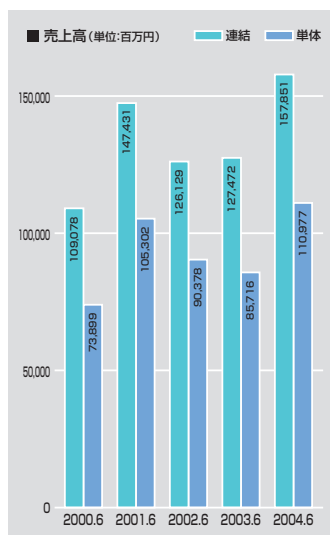
その他の事業につきましては、アルバックソリューションズを生かしたグループ一体となった積極的な拡販活動をおこない、液晶ディスプレイや半導体関連用スパッタリングターゲット材料や部品洗浄などの材料ビジネスと、ナノテクノロジー関連表面分析機器の受注、売上が堅調でした。

その結果、受注高につきましては、240億34百万円、受注残高64億40百万円、売上高につきましては、238億80百万円となりました。また、営業利益につきましては4億93百万円となりました。(なお、上記金額には消費税等は含まれておりません)

▶当社グループが対処すべき課題

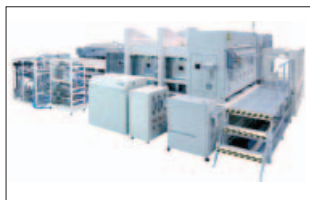
当社グループの主要なお客様であるフラットパネルディスプレイ・電子部品業界及び半導体業界での設備投資意欲は依然旺盛であると予想され、地域的には、韓国・台湾・中国と日本が好調を維持すると思われま。このような市場環境において、お客様満足度向上に努め、独創的な商品開発をおこない、受注を拡大し、コストダウンを一層推進してまいります。

すなわち、生産改革第2段階を軌道に乗せ、標準装置から開発装置まで完成度の高い手離れの良い製品を製作することで、収益力の向上をめざします。また、大型基板ディスプレイ用装置だけでなく、ディスプレイ関連装置のラインナップを増やし、化合物半導体やMEMS、光学膜用製造装置など競争力のある開発をおこなってまいります。グローバル化としては、中国やロシアなどを中心に事業拡大のための基礎固めをおこなってまいります。また、韓国では、液晶ディスプレイ製造装置生産工場の建設をおこなう予定です。



▶ 世界最高出力の固体グリーンレーザーアニール装置を開発 (2003年8月) New Product

アルバックは、低温ポリシリコンTFT用で、FPDのキー製造工程のシリコン多結晶化に用いられる「固体グリーンレーザーアニール装置」を新規開発しました。本装置には三菱電機殿が開発した200Wの固体グリーンレーザー発振器が搭載され、105mmの長尺ラインビームで第5世代(1,150mm×1,300mm)のガラス基板まで加工できます。



固体レーザーアニール装置

▶ 米国ライトレックス社の株式を取得 (2003年8月)

アルバックは、米国ライトレックス社の株式の50%を取得しました。同社は、英国CDT(ケンブリッジディスプレイテクノロジー)社の子会社で、高度な産業用インクジェット装置で実績を持ち、高分子有機EL(LEP)の基本特許を有しています。この株式取得によってアルバック、CDT両社による共同研究が進むことになりました。

2003.7

2003.8

2003.11

2004.2

▶ MEMSファンドリーサービスを開始 (2003年11月) New Product

アルバックはMEMS(Micro Electro Mechanical System)用装置とプロセスを使ったファンドリーサービスを開始しました。アルバックではこれまでウェハーレベルでの成膜・加工サービスを提供してきましたが、その際、MEMSデバイスの製作までを依頼されるケースが増えていました。こうしたニーズに対応するため、リソグラフィなどMEMSの加工ラインを整備し、成膜・エッチングはもとより、設計からダイシング・ボンディングまでの一貫ラインを立ち上げました。

▶ 世界最大級のドライ式真空ポンプを開発 (2003年11月) New Product

アルバックは世界最大級の排気速度(最大毎分58,000リットル)を有するドライ式真空ポンプを開発しました。これは第7世代の大型LCD製造用で、従来機と比較して排気速度は約2倍、到達圧縮時での電力消費は同等としながら、設置面積は約15%の増加におさえ、さらにドライポンプ省電力化アタッチメントを接続すれば25%の消費電力削減が可能です。薄型テレビなどで需要が急拡大しているLCD製造装置用のドライ式真空ポンプでトップシェアを獲得することが期待されています。

▶ 米国JDSユニフェーズ社と新たにライセンス契約を締結 (2004年2月)

アルバックとJDSユニフェーズ社は、新たに光学膜用スパッタ技術に関するグローバルな専用実施権付ライセンス契約を締結しました。契約対象は、JDSユニフェーズ社が特許を持つメタモード[®]スパッタで、薄膜の金属酸化物を形成する成膜技術です。この技術は、①基板を低温のまま薄膜が可能②平滑な成膜が可能③成膜速度が増大等の特徴があります。また、今回の合意により、マーケットに制限無くライセンスの範囲が広がり、すべての光学用途でも制限無くスパッタリング装置ULDIsを販売することが可能になりました。

▶ 東京証券取引所第一部に株式を上場 (2004年4月)

アルバックは2004年4月20日に東京証券取引所市場第一部へ株式を上場いたしました。アルバックグループが今後も継続的に発展を続けるためには、国内外の拠点整備や技術開発に巨額の資金を必要とします。この度の上場によって、資金調達の多様化と財務体質の強化が達成されたほか、社会的信用や知名度のさらなる向上が図られることになりました。



東証アローズのオープンプラットフォームで

2004.4

▶ 愛発科真空技術(蘇州)有限公司(アルバック蘇州)が本格稼働を開始(2004年5月)

2003年7月に設立されたアルバックの100%子会社であるアルバック蘇州の工場が竣工し、稼働を開始しました。(竣工した第1期工場は、4,167.5m²、投資額は約8億円) 今後は、急成長を続ける中国市場において引き合いの多いエレクトロニクス用真空装置や一般産業用の真空熱処理炉などの製造・販売を行う一方、装置納入後にお客様に提供するCSソリューションパッケージを実現する体制も整備していきます。

2004.5

2004.7

▶ アルバック九州・鹿児島事業所に大型FPD製造装置対応クリーン工場が完成(2004年2月)

アルバック九州は、FPD製造装置、電子部品及び半導体製造装置の製造等をおこなっているアルバックの連結子会社です。同社の鹿児島事業所に2004年2月、大型FPD製造装置対応クリーン工場が増設され稼働を開始しました。このクリーン工場は、面積4,130m²、クリーンクラス1,000で、FPDの大型化に対応した次世代製造装置の製造に最適な工場となっています。

▶ 韓国における生産拠点を大規模拡充(2004年7月)

アルバックは、連結子会社の韓国アルバックに大型基板液晶ディスプレイ(LCD)製造装置のクリーン工場を新設することを決定しました。すでに稼働中である平澤工場近傍の玄谷工業団地に土地を取得し、第7世代以降用のLCD製造装置のクリーン工場を建設します。2005年3月に竣工予定です。また、大型装置用部品製作を目的とした新会社「韓国ULVAC精密」、部品表面処理の新会社「PS Tech.」を設立し、韓国におけるアルバックの拠点を大幅に拡充します。



工場完成予想図

▶ アルバック精機に真空ポンプ用の新工場を建設(2004年7月)

アルバックは、連結子会社で真空ポンプ、真空バルブ等の製造を行っているアルバック精機の新工場増設を決定しました。LCDをはじめとするFPDの設備投資が堅調であり、今後この分野における真空ポンプの需要がさらに高まると予想されます。新工場はアルバック鹿児島工業団地内に立地し、建屋面積は約6,000m²。2005年3月に竣工予定です。



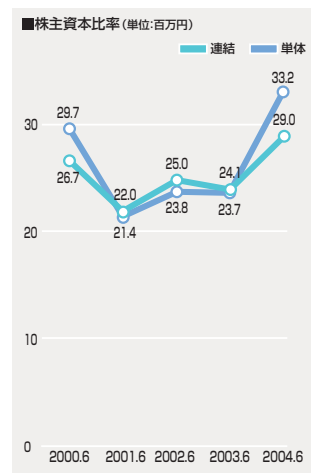
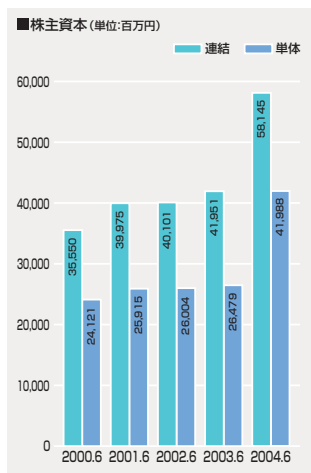
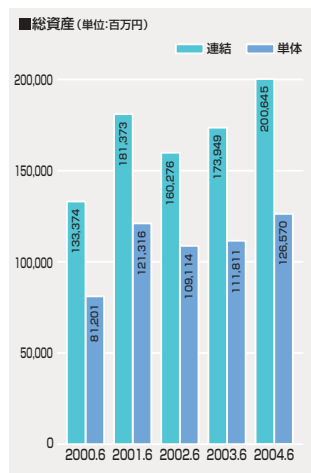
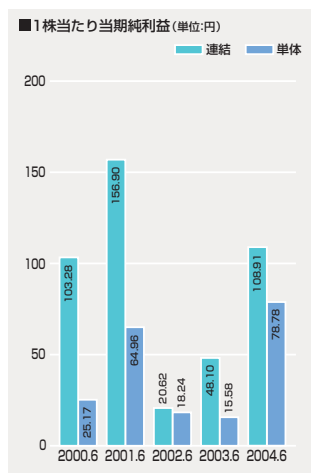
アルバック
鹿児島工業団地概要

- ① アルバック九州(株)
- ② アルバック精機(株)
- ③ アルバック機工(株)
- ④ 洗浄センター
- ⑤ UMAT(株)

▶連結貸借対照表

(単位:百万円)	当連結会計年度		前連結会計年度	
	2004年6月30日現在		2003年6月30日現在	
資産の部	金額		金額	
流動資産	136,859	116,375		
現金及び預金	17,886	15,683		
受取手形及び売掛金	66,387	51,878		
たな卸資産	47,213	43,587		
繰延税金資産	2,956	2,776		
その他	2,653	2,782		
貸倒引当金	△236	△334		
固定資産	63,785	57,572		
有形固定資産	46,348	44,248		
建物及び構築物	20,731	17,387		
機械装置及び運搬具	14,156	13,307		
その他	11,461	13,553		
無形固定資産	2,399	853		
投資その他の資産	15,039	12,469		
投資有価証券	8,464	6,775		
繰延税金資産	2,876	2,605		
その他	3,698	3,088		
繰延資産	1	1		
資産合計	200,645	173,949		

(単位:百万円)	当連結会計年度		前連結会計年度	
	2004年6月30日現在		2003年6月30日現在	
負債の部	金額		金額	
流動負債	104,312	94,257		
支払手形及び買掛金	50,153	35,536		
短期借入金	34,847	42,691		
その他	19,311	16,030		
固定負債	34,921	34,545		
社債	2,700	3,000		
長期借入金	23,161	23,449		
その他	9,059	8,095		
負債合計	139,233	128,803		
少数株主持分	3,268	3,194		
資本の部				
資本金	8,950	3,850		
資本剰余金	10,181	2,859		
利益剰余金	38,880	35,420		
その他有価証券評価差額金	666	△13		
為替換算調整勘定	△531	△165		
自己株式	△1	△0		
資本合計	58,145	41,951		
負債、少数株主持分及び資本合計	200,645	173,949		



▶連結損益計算書

	当連結会計年度	前連結会計年度
	2003年7月1日から 2004年6月30日まで	2002年7月1日から 2003年6月30日まで
	金額	金額
売上高	157,851	127,472
売上原価	127,854	103,364
売上総利益	29,996	24,108
販売費及び一般管理費	21,521	19,371
営業利益	8,476	4,736
営業外収益	1,357	955
受取利息及び受取配当金	166	134
受取手数料	257	272
持分法による投資利益	289	93
その他	645	454
営業外費用	2,567	2,142
支払利息	977	931
その他	1,590	1,210
経常利益	7,266	3,550
特別利益	394	603
貸倒引当戻入額	143	153
受取保険金	—	44
その他	250	405
特別損失	796	874
投資有価証券評価損	—	686
その他	796	188
税金等調整前当期純利益	6,864	3,278
法人税、住民税及び事業税	3,597	1,869
法人税等調整額	△909	△726
少数株主損益	222	406
当期純利益	3,953	1,729

▶連結剰余金計算書

	当連結会計年度	前連結会計年度
	2003年7月1日から 2004年6月30日まで	2002年7月1日から 2003年6月30日まで
	金額	金額
連結剰余金期首残高	35,420	33,738
連結剰余金増加高	—	248
連結剰余金減少高	493	296
配当金	227	226
役員賞与	266	69
当期純利益	3,953	1,729
連結剰余金期末残高	38,880	35,420

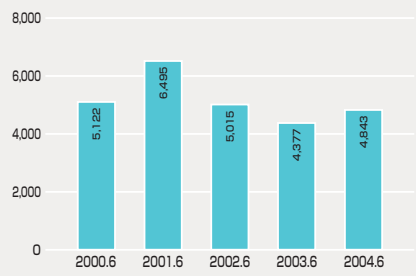
▶連結キャッシュ・フロー計算書

	当連結会計年度	前連結会計年度
	2003年7月1日から 2004年6月30日まで	2002年7月1日から 2003年6月30日まで
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,559	14,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,172	△8,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,357	△881
現金及び現金同等物に係る換算差額	△233	△67
現金及び現金同等物の増加額	1,511	4,279
現金及び現金同等物の期首残高	15,124	10,389
合併による現金及び現金同等物の増加額	—	454
現金及び現金同等物の期末残高	16,635	15,124

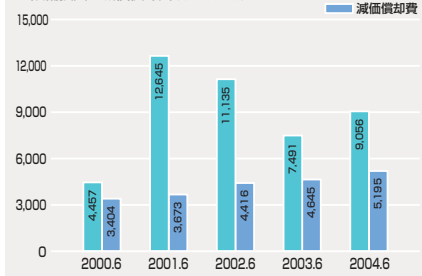
■1株当たり配当金(単位:円)



■研究開発費(単位:百万円)



■設備投資/減価償却費(単位:百万円)



▶単体貸借対照表

(単位:百万円)	当期	前期
	2004年6月30日現在	2003年6月30日現在
	金額	金額
資産の部		
流動資産	80,148	71,188
現金及び預金	7,008	4,906
受取手形及び売掛金	50,656	36,685
たな卸資産	19,545	26,023
繰延税金資産	1,520	1,441
その他	1,450	2,163
貸倒引当金	△32	△30
固定資産	46,421	40,620
有形固定資産	29,561	28,835
建物及び構築物	11,921	10,036
機械装置	10,156	9,421
土地	4,556	4,585
その他	2,928	4,791
無形固定資産	421	397
投資その他の資産	16,439	11,388
投資有価証券	2,404	1,355
関係会社株式	10,150	6,825
その他	3,886	3,207
繰延資産	1	1
資産合計	126,570	111,811
負債の部		
流動負債	60,068	61,175
支払手形及び買掛金	33,458	28,554
短期借入金	18,652	24,836
未払金	2,241	2,970
前受金	594	1,736
その他	5,123	3,077
固定負債	24,515	24,156
社債	2,500	3,000
長期借入金	18,107	17,968
退職給付引当金	3,254	2,580
その他	654	607
負債合計	84,582	85,331
資本の部		
資本金	8,950	3,850
資本剰余金	10,181	2,859
利益剰余金	22,237	19,775
(うち当期純利益)	(2,753)	(569)
株式等評価差額金	620	△5
自己株式	△1	△0
資本合計	41,988	26,479
負債 資本合計	126,570	111,811

▶単体損益計算書

(単位:百万円)	当期	前期
	2003年7月1日から 2004年6月30日まで	2002年7月1日から 2003年6月30日まで
	金額	金額
売上高	110,977	85,716
売上原価	96,363	75,011
販売費及び一般管理費	11,593	10,566
営業利益	3,021	138
営業外収益	2,900	2,553
営業外費用	1,614	1,481
経常利益	4,308	1,211
特別利益	59	118
特別損失	598	624
税引前当期純利益	3,768	705
法人税、住民税及び事業税	1,492	704
法人税等調整額	△477	△567
当期純利益	2,753	569
前期繰越利益	896	609
当期末処分利益	3,649	1,178

▶利益処分計算書

(単位:百万円)	当期	前期
	株主総会承認日 (2004年9月29日)	株主総会承認日 (2003年9月29日)
	金額	金額
当期末処分利益	3,649	1,178
固定資産圧縮積立金取崩額	17	16
計	3,666	1,195
これを次のとおり処分いたします。		
株主配当金	769(1株につき20円)	226(1株につき7円)
役員賞与	86	63
(うち監査役員与金)	(12)	(11)
固定資産圧縮積立金	1	7
別途積立金	800	—
次期繰越利益	2,010	896

Webページ紹介

当社ホームページでは、最新のニュースや技術情報など、当社をご理解いただくための様々な情報を提供いたしております。

www.ulvac.co.jp



(2004年6月30日現在)

- 商号：株式会社アルバック
ULVAC, Inc.
- 商標：ULVAC
- 本社：神奈川県茅ヶ崎市萩園
2500番地
- 設立：1952年8月23日
- 資本金：89億5,000万円
- 従業員数：1,188名

- 連結子会社(2004年9月29日現在)
アルバックテクノ株式会社
アルバック九州株式会社
アルバック東北株式会社
アルバック精機株式会社
株式会社アルバック・コーポレートセンター
アルバック機工株式会社
アルバック理工株式会社
アルバック イーエス株式会社
真空冶金株式会社
ULVAC Technologies, Inc. (米国)
ULVAC TAIWAN, Inc. (台湾)
ULVAC KOREA, Ltd. (韓国)
寧波愛発科真空技術有限公司 (中国)
日本リライアンス株式会社
アルバック・ファイ株式会社
アルバック・クライオ株式会社
UMAT株式会社
Litrex Corporation (米国)

- 役員(2004年9月29日現在)
代表取締役社長 中村 久三
代表取締役副社長 諏訪 秀則
常務取締役 小日向久治
常務取締役 山川 洋幸
常務取締役 桜田 勇蔵
常務取締役 中村 静雄
常務取締役 常見 佳弘
常務取締役 砂賀 芳雄
取締役 小林 茂人
取締役 天野 繁
取締役 柏木 利廣
取締役 福田 隆
取締役(非常勤) 牧野 正志
取締役(非常勤) 木村 光利
監査役 菊城 宏
監査役 川島 和也
監査役(非常勤) 佐藤 恒雄
監査役(非常勤) 長澤 正人

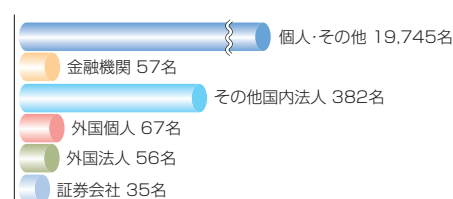
●株式の状況

会社が発行する株式の総数 80,000,000株
発行済株式の総数 38,428,438株
株主数 20,344名

●大株主

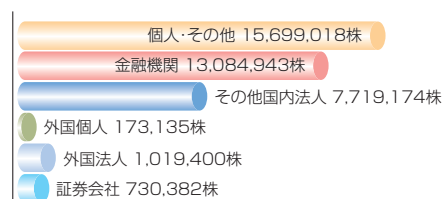
株主名	当社への出資状況 持株数(千株)	当社への出資状況 持株比率(%)
日本生命保険相互会社	3,202	8.33
アルバック持株会	2,194	5.71
株式会社みずほ銀行	1,604	4.17
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井アセット信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口)	1,604	4.17
株式会社UFJ銀行	1,604	4.17
松下電器産業株式会社	1,582	4.12
稲畑産業株式会社	870	2.26
星光ビル管理株式会社	735	1.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	727	1.89
みずほキャピタル株式会社	698	1.82

●所有者別株主数(計20,344名)



証券保管振替機構名義株式：1名 自己名義株式：1名

●所有者別株式数(計38,428,438株)



証券保管振替機構名義株式：1,800株 自己名義株式：586株

■株主メモ

決算期	6月30日(配当金受領株主確定日)
定時株主総会	9月下旬
基準日	6月30日(臨時に必要なときは予め公告した日)
名義書換代理人	東京都港区芝3丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
お問い合わせ先	中央三井信託銀行株式会社 証券代行部(証券代行事務センター) TEL.03(3323)7111(代表)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店、全国各支店
公告掲載新聞	日本経済新聞

ULVAC
www.ulvac.co.jp

株式会社アルバック

本社/工場
〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500
TEL. 0467-89-2033

東京事務所
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-3-1
TEL. 03-5218-5700